【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成21年3月26日(2009.3.26)

【公開番号】特開2007-235791(P2007-235791A)
【公開日】平成19年9月13日(2007.9.13)
【年通号数】公開・登録公報2007-035
【出願番号】特願2006-57308(P2006-57308)
【国際特許分類】
Ｈ０３Ｂ　5/32　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０３Ｂ　5/32　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月4日(2009.2.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧電素子が収容された圧電素子パッケージと、ＩＣチップが搭載された回路基板とを備え、前記圧電素子パッケージの底面に前記回路基板が接続された圧電デバイスであって、
前記回路基板には底壁と側壁を有する凹部が形成され、さらに前記底壁の一部が貫通された開口部を備え、前記開口部に前記ＩＣチップが固定部材により固定され、前記回路基板の底壁に形成された端子と前記ＩＣチップのパッドとが金属ワイヤで接続されていることを特徴とする圧電デバイス。
【請求項２】
請求項１に記載の圧電デバイスにおいて、
前記回路基板の凹部に前記ＩＣチップおよび前記金属ワイヤを覆う保護用樹脂が充填されていることを特徴とする圧電デバイス。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】